

2007年度 CMP技術の基礎を理解する - サマーキャンプのご案内

目的: CMP技術の基礎を, チュートリアル形式で講義する.

日時: 2007年8月30日(木), 31日(金)

場所: 吉祥寺 東急イン (JR中央線吉祥寺駅公園口(南口)出口→徒歩約1分)  
〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-6-3  
Tel. 0422-47-0109 Fax. 0422-43-1811

見学先: 次世代半導体材料技術研究組合(CASMAT)

参加費: 39,000円(サマーキャンプ/見学会参加)  
(※宿泊は2人部屋になりますが、もし1人部屋ご希望の場合、41,000円となります。)

▼スケジュール

8月30日(木)	
12:50	CASMATに集合
13:00-16:00	CASMAT 見学 (1) CASMATの概要について (2) 研究施設見学 (3) 特別講演:CASMATにおける研究活動(CMP関係を中心に)
16:00-17:00	ホテルへ移動
17:00-19:30	夕食 など
19:30-19:45	開講の辞 - サマーキャンプでの過ごし方 (木村景一)
19:45-20:30	講義 1 : パラダイムシフトが進む半導体産業の中で市場が拡大するCMP関連産業 グローバルネット 武野泰彦
20:30-	懇親会
8月31日(金)	
9:00-10:15	講義 2 : CMPにおける材料除去の基礎 九州工業大学 木村景一
10:15-11:45	講義 3 : CMPにおけるスラリーとポリシングパッド 交渉中
11:45-13:00	昼食
13:00-14:20	講義 4 : CMP装置とCMPプロセス 荏原総合研究所 檜山浩国
14:20-15:20	講義 5 : CMPポスト洗浄 荏原製作所 濱田聡美
15:20-15:40	Coffee break
15:40-16:40	講義 6 : CMPプロセスにおける計測 日立製作所 山田洋平
16:40-17:00	閉会式 - 閉会の辞 (木村景一)

(敬称略)